

2023年3月期 第1四半期（2022年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2022年8月8日

内容：

- 連結決算の概要 執行役員 ファイナンスユニットGM 川本 弘
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第1四半期 連結決算の概要

2022年8月8日

川本 弘

Global Business Platform本部 副本部長
執行役員 ファイナンスユニットGM



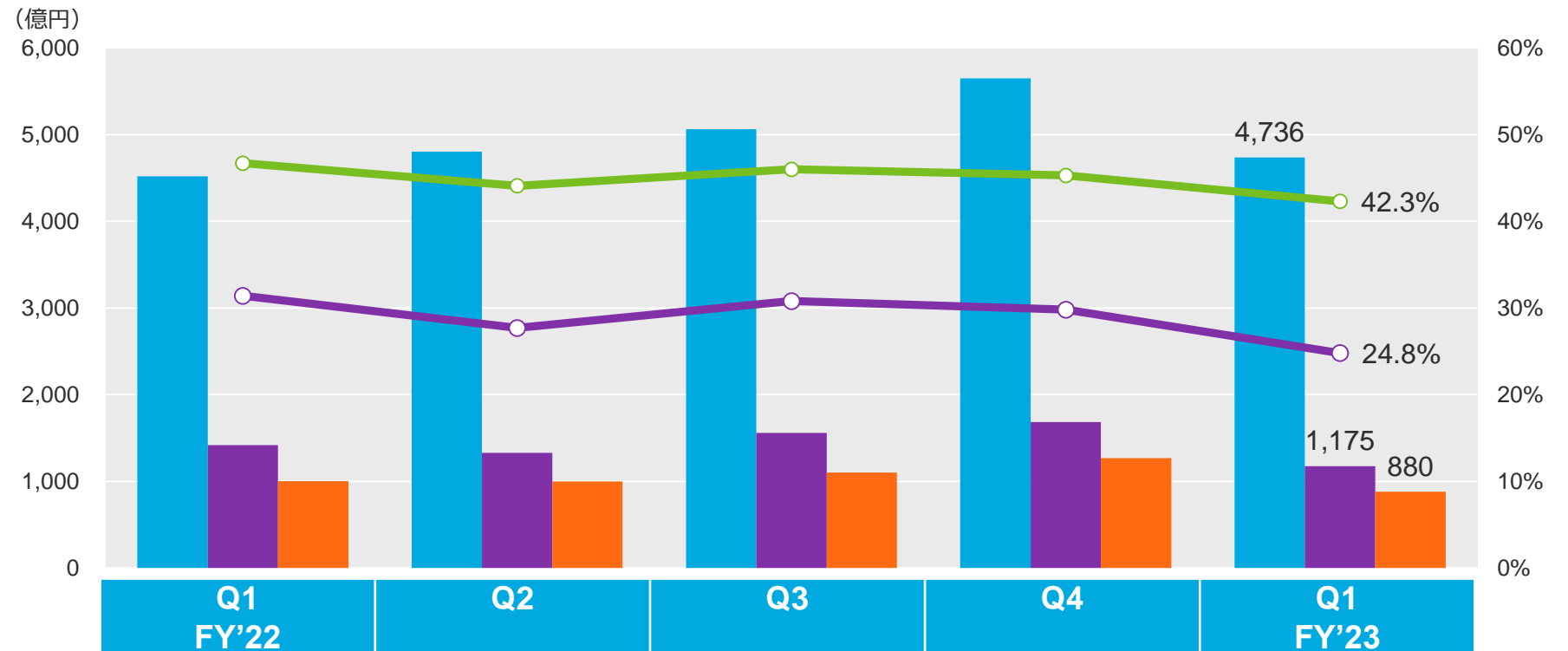
損益状況

(億円)

	FY2022				FY2023	対FY2022 Q4 増減
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
売上高	4,520	4,804	5,064	5,648	4,736	-16.1%
SPE	4,379	4,678	4,888	5,492	4,640	-15.5%
FPD	140	125	176	155	96	-38.0%
売上総利益	2,109	2,119	2,330	2,559	2,005	-21.7%
下段：売上総利益率	46.7%	44.1%	46.0%	45.3%	42.3%	-3.0pts
販管費	691	790	769	873	830	-5.0%
営業利益	1,417	1,328	1,560	1,685	1,175	-30.3%
下段：営業利益率	31.4%	27.7%	30.8%	29.8%	24.8%	-5.0pts
税金等調整前当期純利益	1,380	1,350	1,555	1,681	1,176	-30.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,003	998	1,100	1,268	880	-30.5%
研究開発費	343	411	385	441	421	-4.6%
設備投資額	106	145	174	147	180	+22.9%
減価償却費	79	88	96	102	97	-5.3%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

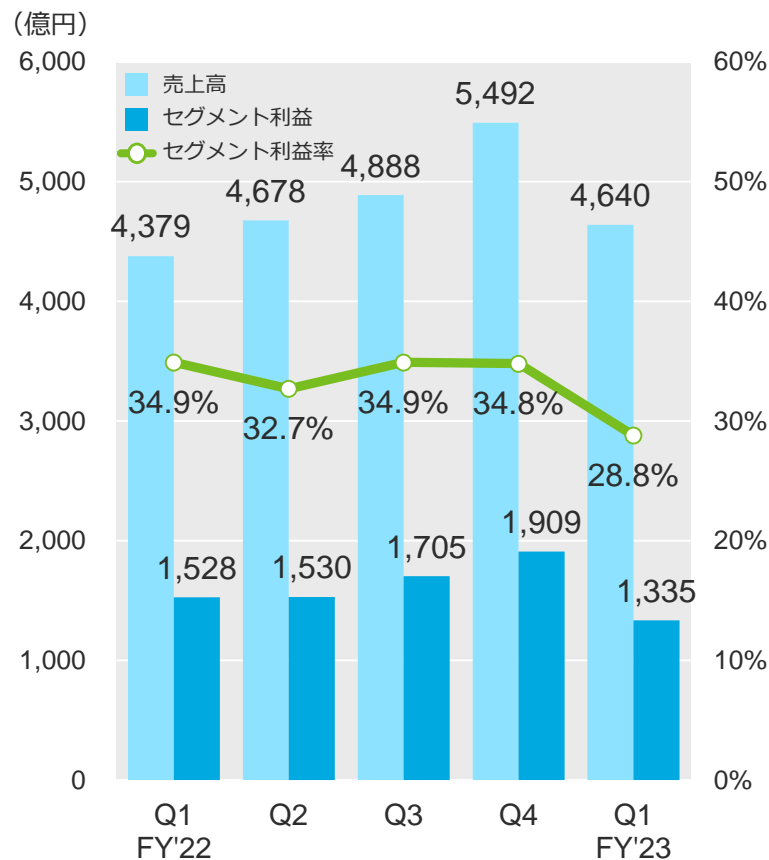
損益状況



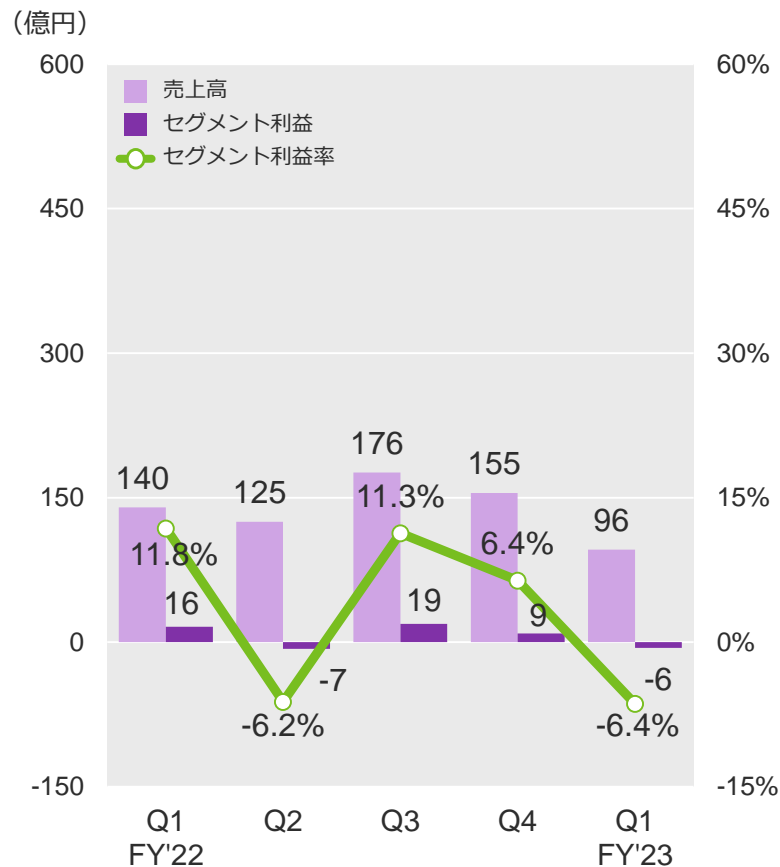
売上高	4,520	4,804	5,064	5,648	4,736
営業利益	1,417	1,328	1,560	1,685	1,175
親会社株主に帰属する当期純利益	1,003	998	1,100	1,268	880
売上総利益率	46.7%	44.1%	46.0%	45.3%	42.3%
営業利益率	31.4%	27.7%	30.8%	29.8%	24.8%

セグメント情報

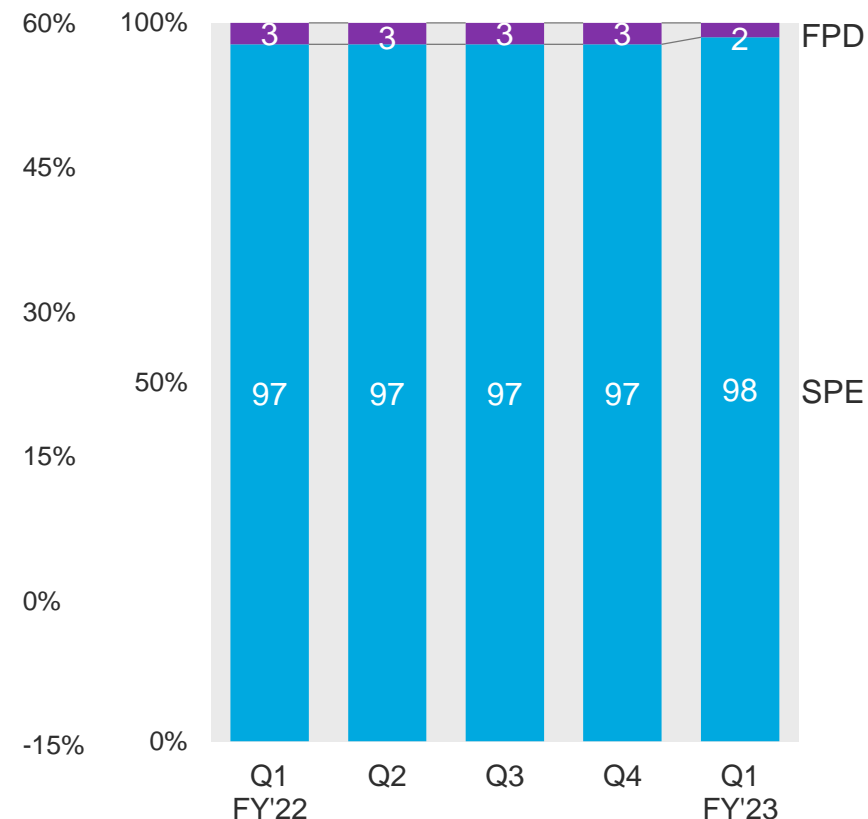
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



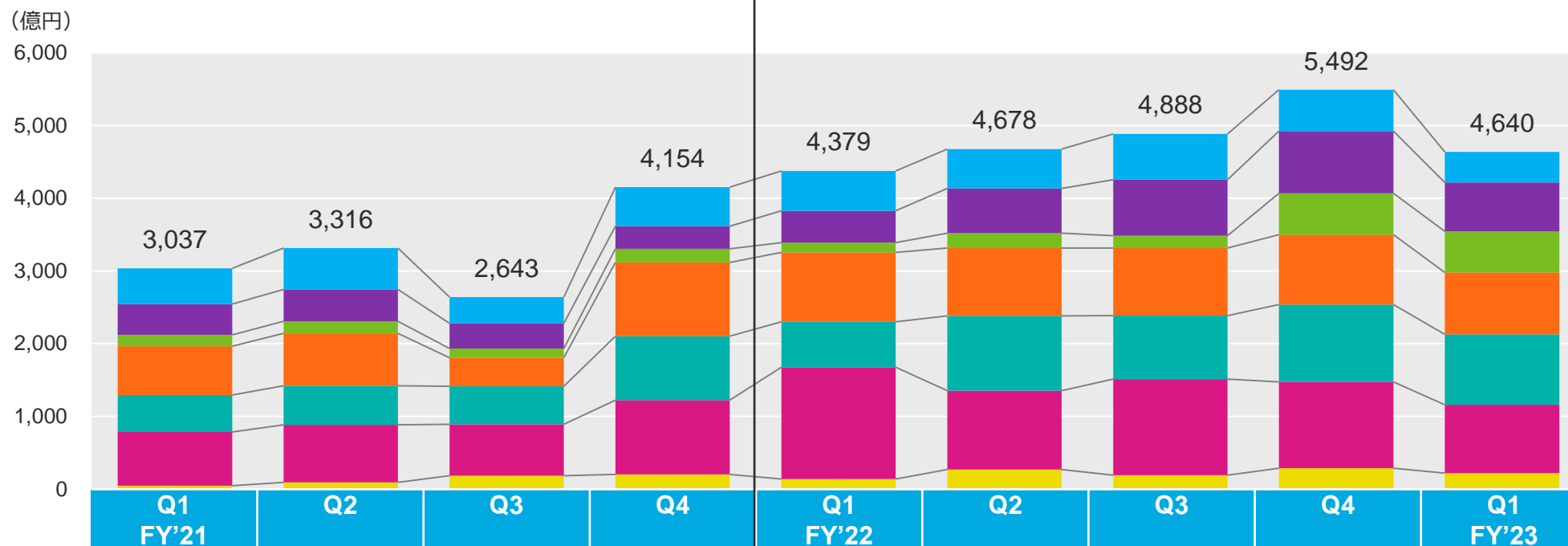
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

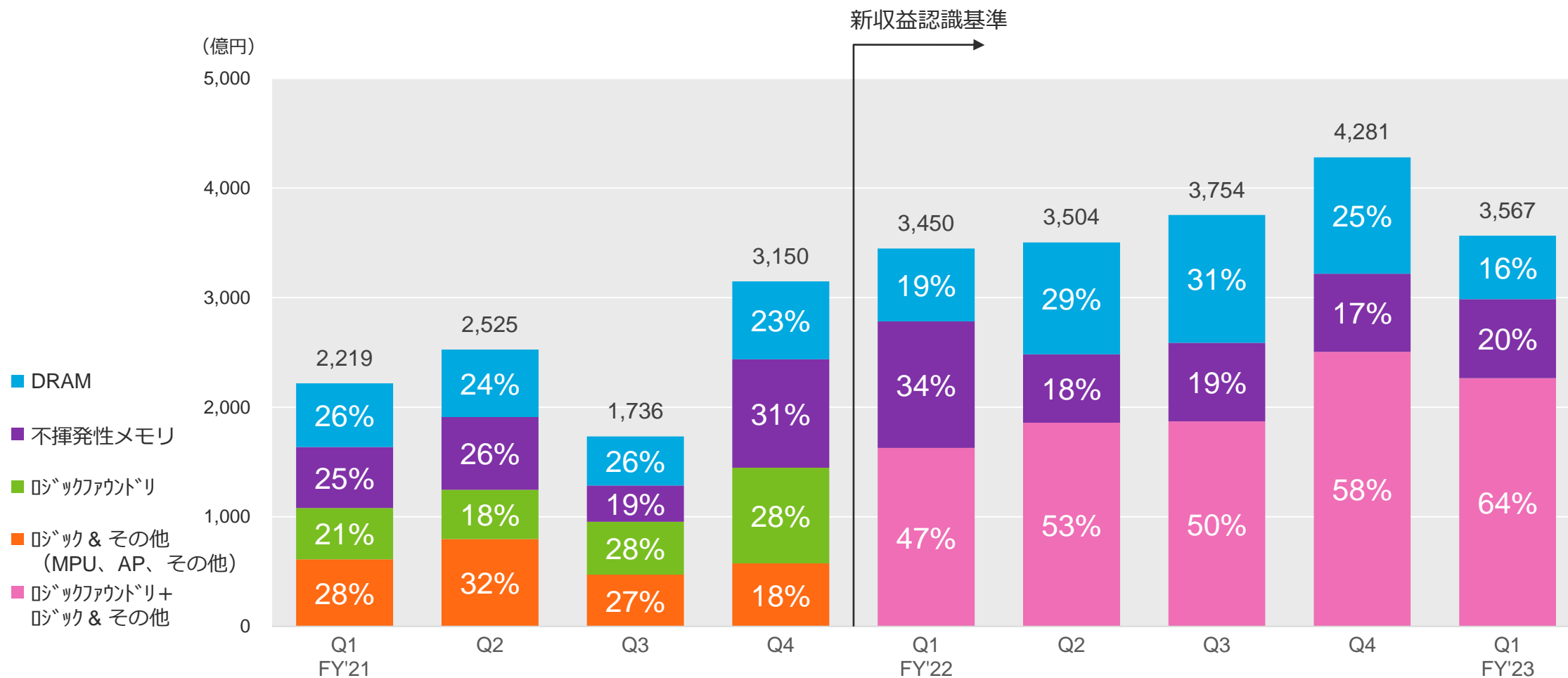
SPE部門 地域別売上高

新収益認識基準

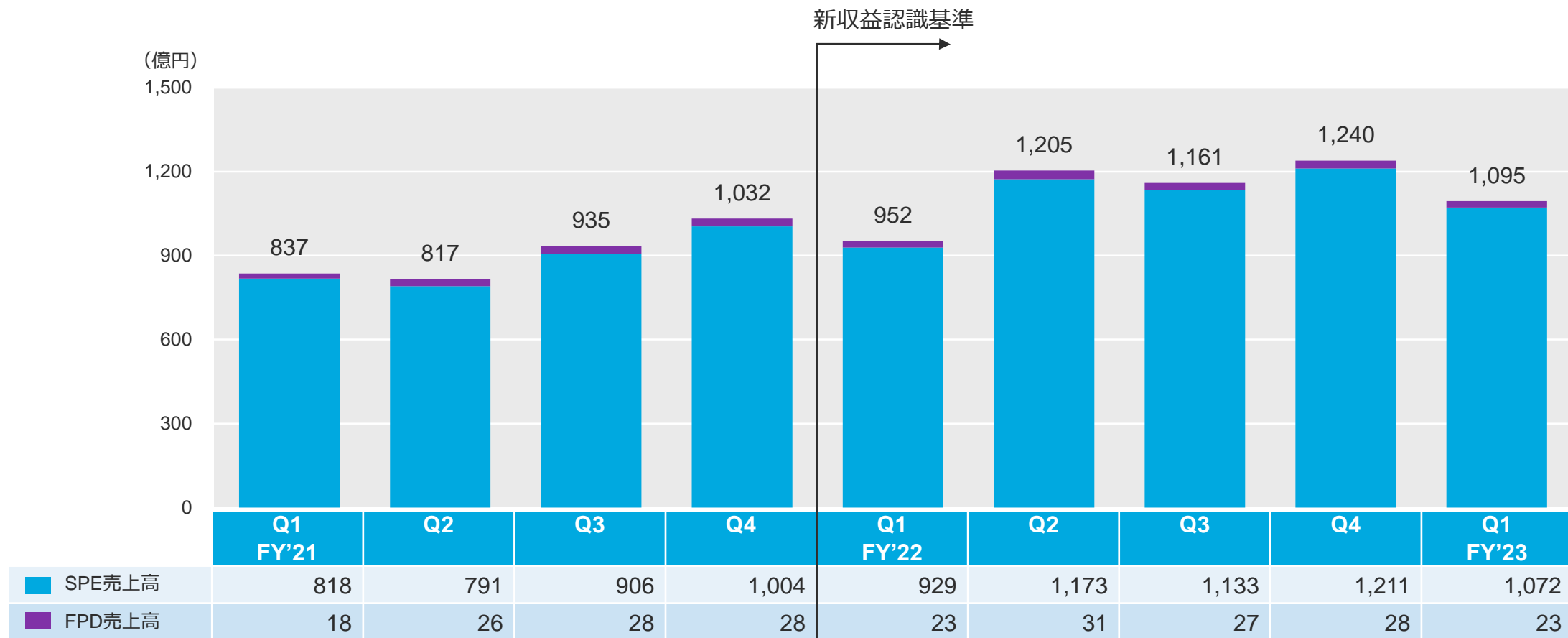


	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'22	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'23
■ 日本	491	568	361	536	548	539	631	569	420
■ 北米	423	440	345	312	439	618	768	853	673
■ 欧州	157	163	127	186	134	203	170	571	565
■ 韓国	670	721	393	1,014	953	935	930	959	851
■ 台湾	509	539	525	882	628	1,025	874	1,063	968
■ 中国	739	791	705	1,022	1,536	1,088	1,322	1,188	940
■ 東南アジア・他	46	92	184	200	138	267	189	287	220

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



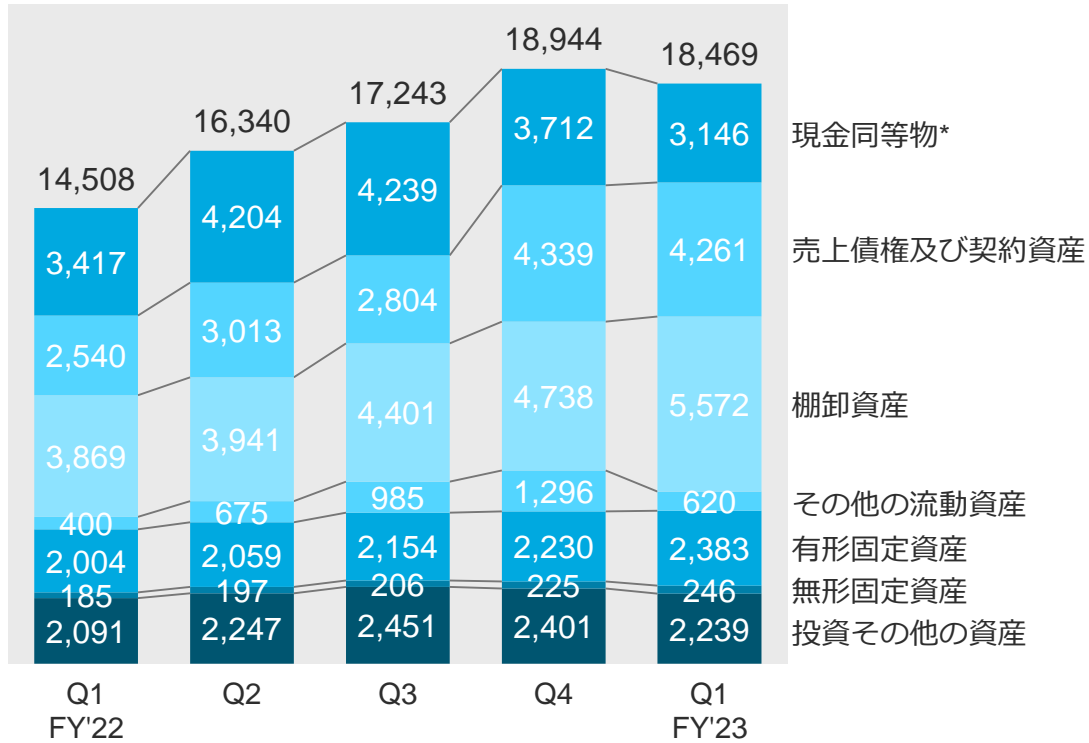
フィールドソリューション売上高



貸借対照表

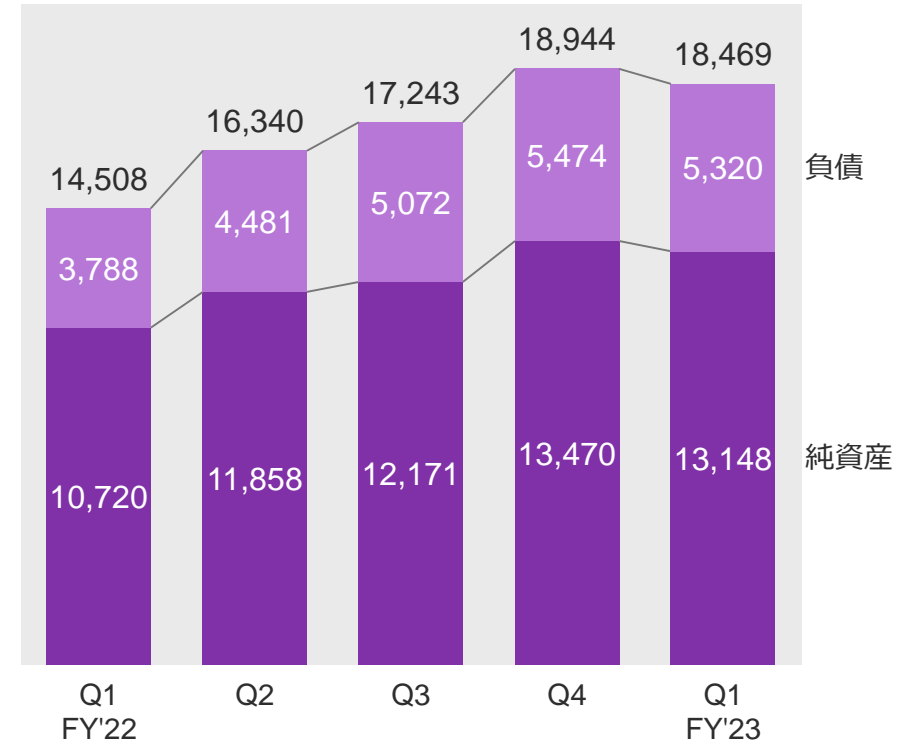
資産

(億円)



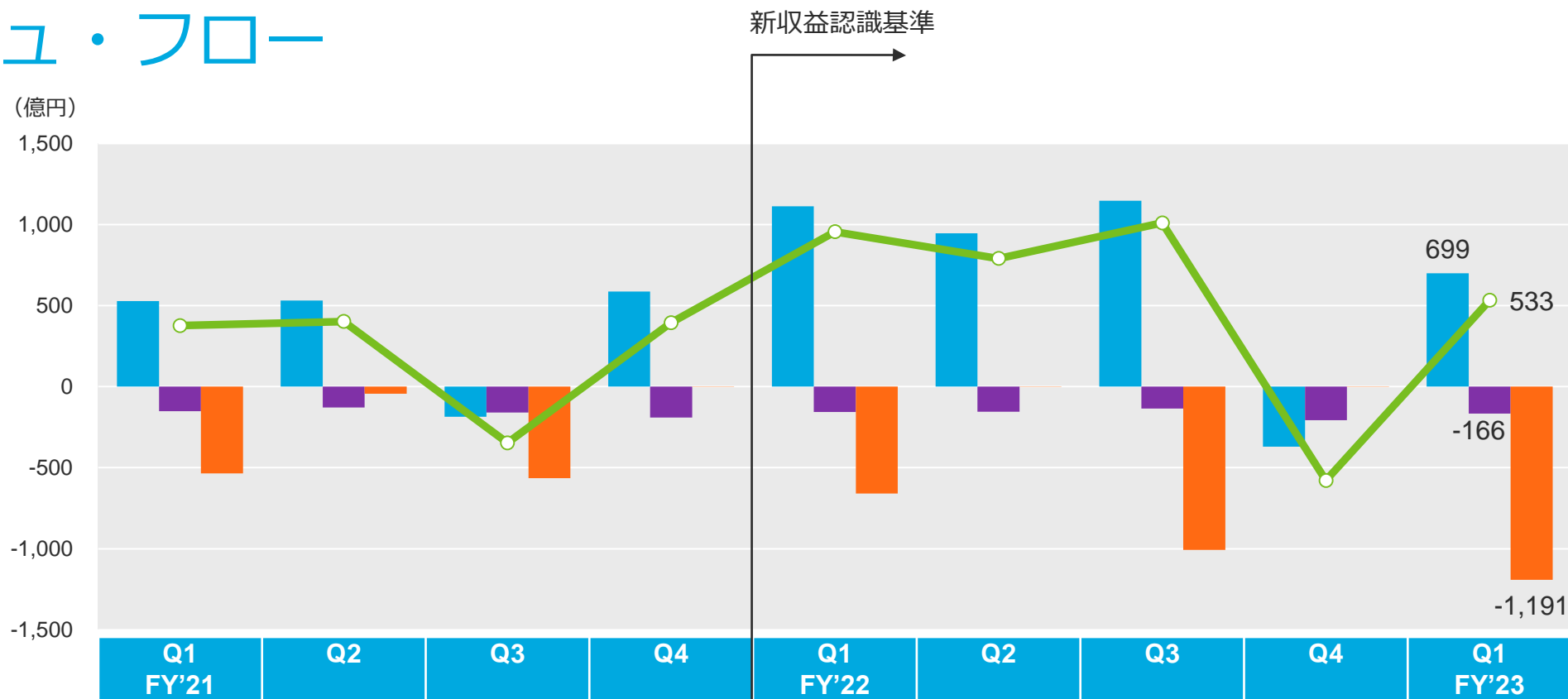
負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー



*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

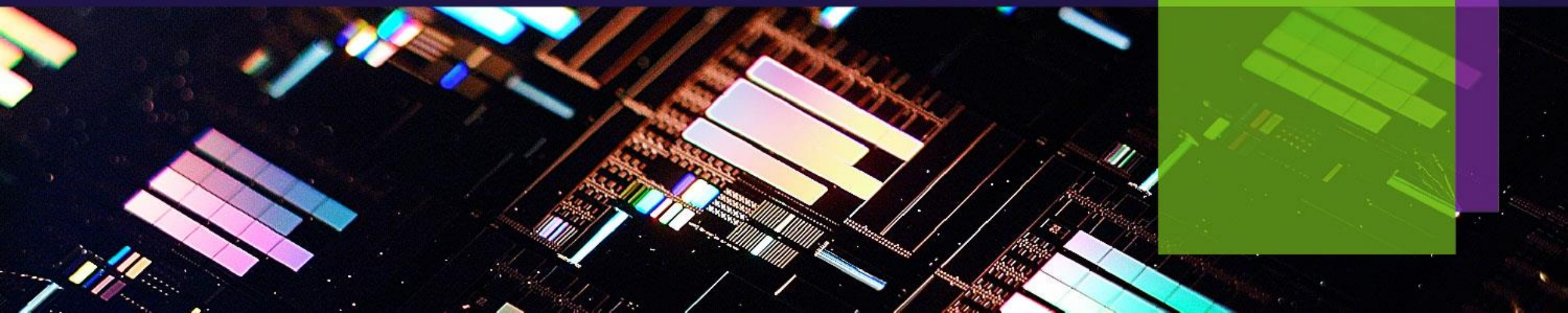
*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。



事業環境および業績予想

2022年8月8日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



CY2022 事業環境（2022年8月時点での見方）

- 半導体前工程製造装置 (WFE)*¹市場
 - 前年比5～15%の成長を見込む。
マクロ経済の減速懸念、部材不足や物流の混乱による影響、大幅な為替変動を考慮し、CY2022の市場想定を修正。軽微な調整も、社会のデジタルシフトの進展による中長期的な成長に対する見方に変更なし
- FPD製造装置市場 (TFTアレイ工程*²向け)
 - 前年比微増を見込む。
車載など新たなアプリケーションやモバイルの新技術採用に伴う投資が増加。LCDからOLEDへの移行は小型パネルから進行しており、今後は大型パネルへの展開も期待

*1 半導体前工程製造装置 (WFE; Wafer fab equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程 : ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

CY2022 アプリケーション別のWFE市場環境

- ロジック/ファウンドリ：前年比 10～20%の増加
 - 情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が継続し、市場成長を牽引
 - GAA/Nanosheet、Backside PDNなどの技術開発の進展
- DRAM：前年比 5%程度の減少
 - PCやスマートフォンの短期的な調整局面により、見方を変更
 - サーバー向け高速CPUのリリースによるDDR5の拡大、微細化の進展
- 不揮発性メモリ：前年比 10%程度の増加
 - SSDの採用の進捗と搭載容量の増加により投資が拡大
 - 低コスト・大容量化に向け、200層レベルの多層化が進む

FY2023 Q1 事業進捗

- 新中期経営計画（～FY2027）を策定。
短中長期の利益と継続的な企業価値の向上を目指す
 - 新財務モデル：売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE30%以上
 - 新ビジョン：「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」
 - 新中長期環境目標：温室効果ガス 実質排出量 ゼロ
(Scope1, 2 = 2040年まで、Scope3 = 2050年まで)
 - 積極的な研究開発投資：5年間で1兆円以上を計画
- 戦略製品によるPOR*獲得が順調に進捗

*POR (Process of record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

FY2023 業績予想

FY2023 業績予想

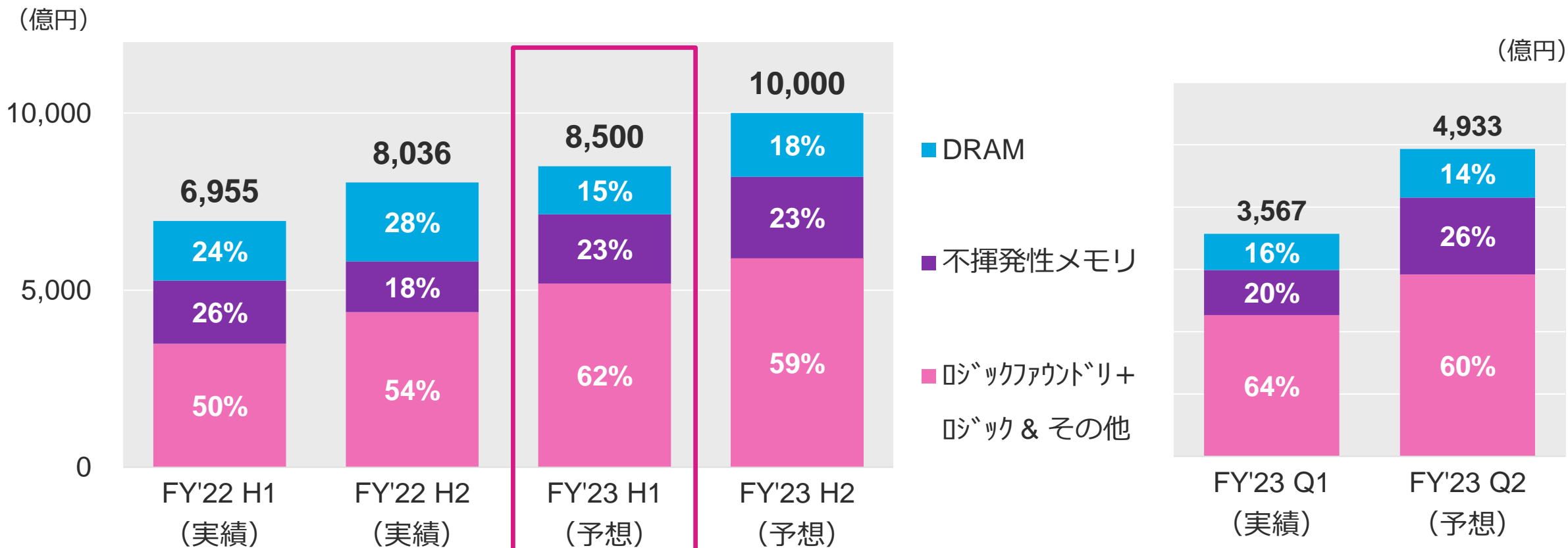
(億円)

	FY2022 (実績)	FY2023 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前期増減
売上高	20,038	11,000	12,500	23,500	+17.3%
SPE	19,438	10,700	12,250	22,950	+18.1%
FPD	598	300	250	550	-8.1%
売上総利益	9,118	4,950	5,800	10,750	+17.9%
下段：売上総利益率	45.5%	45.0%	46.4%	45.7%	+0.2pts
販管費	3,125	1,760	1,830	3,590	+14.9%
営業利益	5,992	3,190	3,970	7,160	+19.5%
下段：営業利益率	29.9%	29.0%	31.8%	30.5%	+0.6pts
税金等調整前当期純利益	5,966	3,190	3,970	7,160	+20.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,370	2,340	2,890	5,230	+19.7%
1株当たり当期純利益 (円)	2,807.84	1,502.29	-	3,357.63	+549.79

業績予想は据え置く。一方、引き続き市場環境は要注視

FY2023 SPE部門 新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



一部装置の出荷時期にずれが発生したが、半期計画に変更なし

FY2023 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,900億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資
- 設備投資 750億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 460億円

新開発棟
(コータ/デベロッパ、サーフェスプレパレーション)

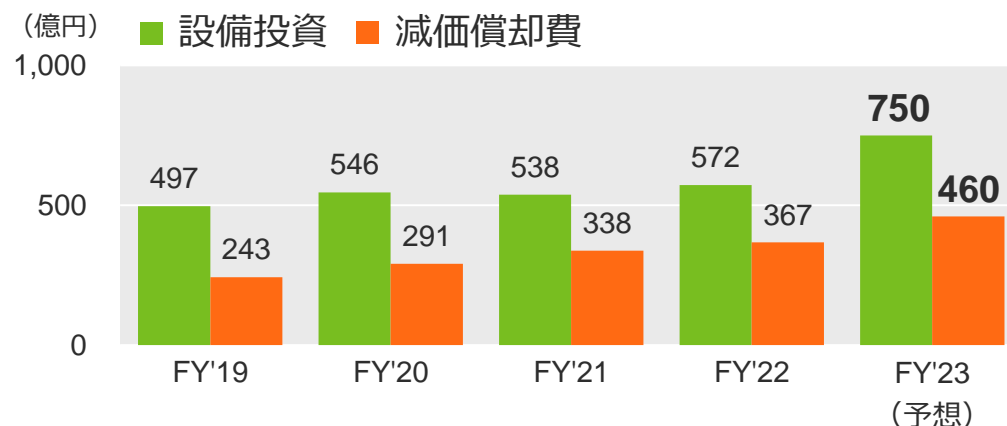
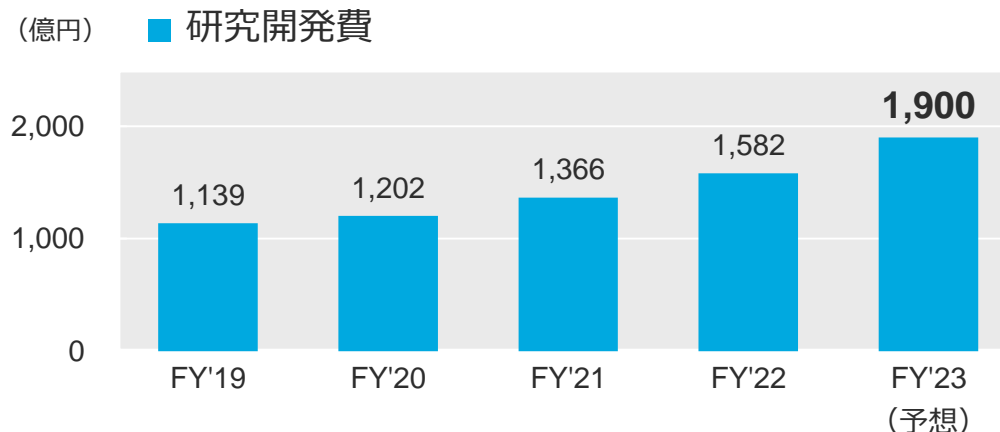


熊本県合志市：建設費約300億円
(2024年秋 竣工予定)

新開発棟
(エッチング装置)



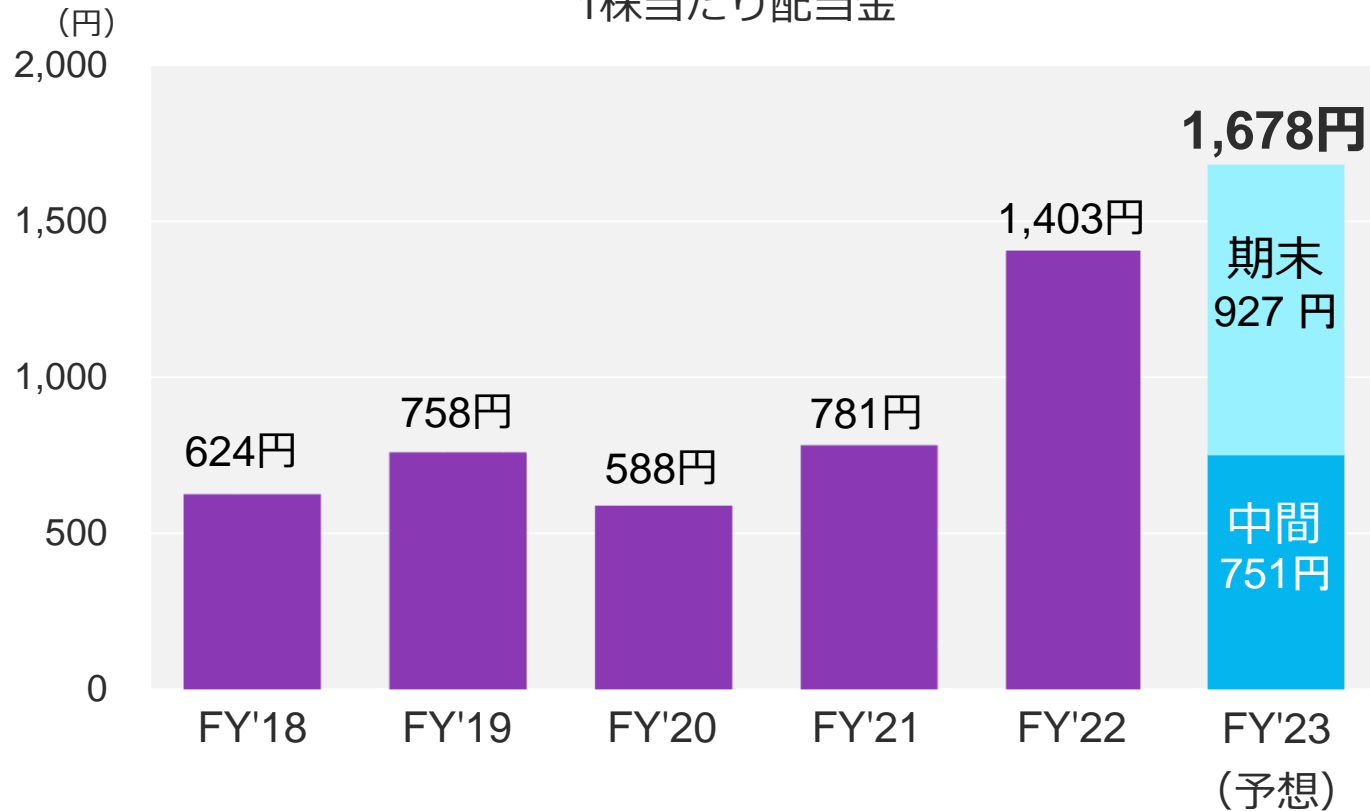
宮城県大和町：建設費約470億円
(2025年春 竣工予定)



拡大する市場と多様化する最新技術ニーズを見据え、
研究開発、設備投資を加速

FY2023 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

通期配当金は1,678円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON